

公司概況資料表

以下資料由漢民測試系統股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：漢民測試系統股份有限公司 (股票代號：7856)

董事長	林冬青
總經理	王子建
資本額	新台幣256,770,000元
輔導推薦證券商	永豐金證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	永豐金證券股份有限公司 羅小姐(02)2316-5510
註冊地國	非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	非屬外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購漢民測試系統股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	永豐金證券股份有限公司	第一金證券股份有限公司
認購日期	114.9.9	114.9.9
認購股數 (股)	671,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.61%	0.39%
認購價格	每股新台幣100元	

認購價格之訂定
依據及方式

本輔導推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為本輔導推薦證券商認購漢民測試系統股份有限公司(以下簡稱漢測或該公司)興櫃股票價格之訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

- (1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
- (2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
- (3)收益法：自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，其中成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握；而市場法中的股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本次輔導推薦證券商認購漢測股票係採用市場法之本益比法進行評估。

該公司目前主係從事半導體測試設備組裝銷售、設備安裝及維修等技術服務。經參考國內已上市櫃從事半導體設備機台及零備件公司之同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業：(1)精測(上櫃公司，股票代號6510)主要營業項目為晶圓探針卡及半導體設備之製造及銷售(2)志聖(上市公司，股票代號2467)主係從事印刷電路板製程、半導體製程及前瞻製程等設備銷售(3)旺矽(上櫃公司，股票代號6223)主要營業項目為晶圓控針卡及半導體設備製造及銷售。茲彙總採樣同業最近三個月(114年5月~7月)之平均本益比如下：

單位:倍

同業\月份\平均本益比		114年 5月	114年 6月	114年 7月	平均
採樣 同業	精測	40.71	38.29	32.31	37.10
	志聖	32.61	32.61	31.32	32.18
	旺矽	28.47	33.85	37.61	33.31
上市	半導體	19.62	21.22	23.06	21.30
上櫃	半導體	28.07	28.66	28.82	28.52

資料來源：臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心網站

	<p>參上表整理，該公司採樣同業及上市櫃半導體類股最近三個月之平均本益比為21.30倍~37.10倍之間，另依據該公司113年度及114年第二季經會計師查核簽證或核閱財務報告，最近四季(113年下半年度及114年上半年度)稅後歸屬於母公司業主之淨利157,702千元，以目前股數25,677千股計算，每股稅後盈餘為6.14元，若以此每股盈餘與上述本益比區間為計算基礎，計算其參考價格區間約為130.78元~227.79元，考量興櫃流動性風險給予7折作為風險貼水，調整後本益比法計算之價格區間為91.55元~159.45元。</p> <p>綜上，參考上述本益比法設算價格區間及該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性、同業之市場狀況，及興櫃市場流通性風險等因素後，本輔導推薦證券商與漢測共同議定興櫃認購價格為每股100元，介於上述參考價格區間，經評估該認購價格應尚屬合理。</p>
--	---

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

漢測設立於93年9月，公司致力於提供半導體客戶全面性測試服務，包含設備銷售、安裝、技術支援、製程開發、移機以及客製化設計等。主要產品探針卡(Probe Card)可依照客戶需求，提供高度客製化及在地化製程服務，從研發設計、製程貼合到售後維修服務皆能高度整合，提供一條龍的完整解決方案；主要服務包括提供 AOI Toolkit (Automated Optical Inspection Toolkit，自動光學檢查設備工具包)、FIMS (Flexible Integrated Manufacturing System，彈性整合製造系統)、TEMIC MIS Discovery (特殊晶圓電子束缺陷複檢設備)、Laser Cleaner (雷射清洗機)等客製化設備，以及機台保養、異常問題排除、裝機、移機及改機等工程服務。

二、歷史沿革

年度	重要記事
93年度	● 漢測成立於新竹
97年度	● 建置探針卡 cobra 製造產線
98年度	● 進軍 memory 市場銷售探針卡
103年度	● 提供廠內 DRAM 測試服務
104年度	● 研發後段測試客製化產品，提供測試相關工程服務
105年度	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得 ISO 9001 品質管理系統認證(認證範圍：半導體裝置的生產測試) ● 與工研院合作雷射清針項目 ● 進軍 Fab Automation 測試市場，代理 Get Control, Inc. E84感測器
106年度	<ul style="list-style-type: none"> ● 成立漢民測試系統(蘇州)有限公司 ● Hprobe 測試機推廣至市場 ● 榮獲2017年新竹區「傑出總經理獎」
107年度	● 研發客製自動化產品

109年度	<ul style="list-style-type: none"> 建置探針卡製造產線，技術轉移 Micronics Japan Co., Ltd.懸臂式探針卡之製造技術 2020 tsmc F7 Supplier Excellence Award
110年度	<ul style="list-style-type: none"> 成立漢民測試系統股份有限公司南科分公司 佈局薄膜式探針卡及 Probe Card PGV 業務
111年度	<ul style="list-style-type: none"> 與信通交通器材股份有限公司共同投資成立德宸材料股份有限公司 建置 in-house 表面貼裝技術產線(SMT) 取得 ISO 9001品質管理系統認證(認證範圍：探針卡設計與製造) 榮獲2022年新竹區傑出經理選拔「傑出研究發展管理獎」
112年度	<ul style="list-style-type: none"> 成立 Hermes Testing Solutions Japan 株式会社 2023 tsmc F15B Supplier Award 代理 Advantest 光罩量測掃描電子顯微鏡
113年度	<ul style="list-style-type: none"> EasyCool Ultra 客製化產品取得 SEMI S2認證
114年度	<ul style="list-style-type: none"> MJC 與漢測攜手展開策略合作，強化台灣半導體測試佈局 漢測榮獲經濟部第九屆「國家產業創新獎」，展現其創新研發實力

三、經營理念

漢測成立至今，秉持本土扎根及在地研發之理念，以卓越產品開發及技術能力，打造高度客製化之測試解決方案，以成為半導體測試產業標竿為目標。從封裝前晶圓測試到2D 及3D 缺陷檢測，致力於為客戶把關產品品質，在台灣及日本多處設置在地化製造產線及快速回覆之售後服務，提升生產效率與品質，持續推動台灣半導體產業發展，成為客戶最值得信賴的合作夥伴。

本公司2020年建置探針卡製造產線，並佈局薄膜式探針卡及 Probe Card PGV (Person Guided Vehicle 人工導引車)等業務，致力於發展可靠及高效之探針卡，以革命性創新應對更高頻、高功率之晶圓需求，提供各種針型、針種之晶圓探針卡，可應用於各式終端產品，包含 HPC、5G、AIoT 及電動車等高頻領域。本公司持續專注於技術創新和品質保證，通過獨特的針型設計及製程手法，擁有散熱優異及高乘載電流等特點，確保產品在高頻環境下之穩定性及可靠性，有效提高探針卡使用壽命。

展望未來，漢測將持續深耕半導體測試設備市場，強化國際競爭力，並攜手全球合作夥伴，共同創造永續未來。

四、未來展望

(1)短中期發展計畫

本公司短期內將持續聚焦於核心產品線之優化與量產穩定性提升，並強化與既有客戶之合作深度與黏著度。同時，配合新廠房建置規劃，推進製造與維修服務能量之擴充，提升交期效率與整體營運彈性。此外，亦將持續投入研發資源於關鍵模組自主設計以厚植技術基礎與市場差異化優勢。

(2)長期業務發展計畫

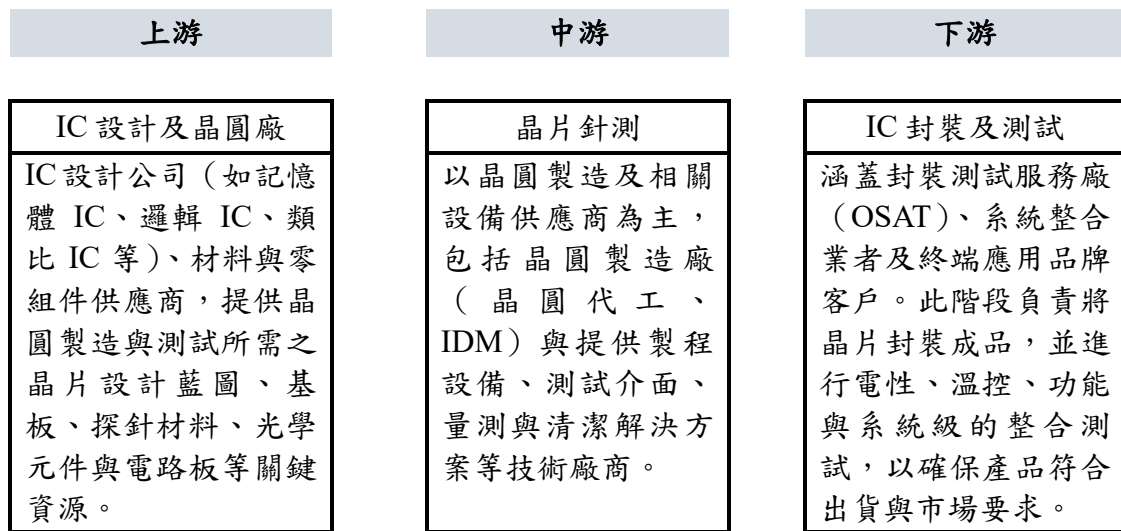
中長期而言，公司將朝向發展完整測試配套解決方案供應商的角色邁進，涵蓋測試介面、檢測與清潔、熱控模組至自動化平台，提升一站式整合能力與產品附加價值。未來亦將積極開拓海外市場，視營運成長與客戶需求評估海外據點設

立之可行性，擴大國際服務網絡。此外，公司將持續強化研發實力與組織規模，提升營運韌性與永續經營能力，以因應半導體高階製程與多元封裝技術日益提升之市場需求。



主要業務項目：

本公司主要提供探針卡、雷射清潔機、熱控模組、AOI 檢測系統與相關測試耗材，協助客戶完成晶圓測試與成品驗證工作。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



本公司主要提供探針卡、雷射清潔機、熱控模組、AOI 檢測系統與相關測試耗材，協助客戶完成晶圓測試與成品驗證工作，位屬半導體產業之中游。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
半導體技術服務		提供客戶現場支援包含設備重組、維修、年度與季度保養等完整服務。	913,850	57.20
半導體設備及零組件		研發製造半導體客製化設備，包括雷射清潔機、光學與 AOI 檢測系統、探針卡平整監控、溫控系統及晶圓量測校正等，以提升測試精度與效率。	683,915	42.80
合計			1,597,765	100.00

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年度 (註2)	110年度 (註2)	111年度 (註3)	112年度 (註3)	113年度 (註3)	114年截至8月份止 (自結數)(註4)
營業收入		1,008,752	1,114,667	1,152,273	809,203	1,597,765	1,403,145
營業毛利		246,546	208,162	270,674	175,417	578,908	633,883
毛利率(%)		24.44	18.67	23.49	21.68	36.23	45.18
營業損益		26,384	74,008	(21,786)	(217,426)	53,550	184,146
營業外收入		32,256	46,569	4,611	19,912	17,549	36,277
營業外支出		(18,641)	(7,152)	(15,443)	(11,561)	(14,334)	(27,954)
稅前損益		39,999	113,425	(32,618)	(209,075)	56,765	192,469
稅後損益		13,807	99,891	(33,093)	(210,432)	56,765	169,876
每股盈餘(元)		1.37	9.89	(1.65)	(10.52)	2.84	7.00
股利發放	現金股利(元)	-	-	-	-	-	(尚未分配)
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	(尚未分配)
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	9.80	-	-	(尚未分配)

註1：上述各年度財務資料均經會計師查核簽證之財務報告

註2：109年度及110年度係採用我國企業會計準則編製之個體財務報告；每股盈餘未經會計師查核，係以歸屬於母公司普通股權益持有人之損益（分子），除以當期流通在外普通股加權平均股數（分母）計算之。

註3：111~113年度係採用國際財務報導準則編製之合併財務報告

註4：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估；每股盈餘係以歸屬於母公司普通股權益持有人之損益（分子），除以當期流通在外普通股加權平均股數（分母）計算之。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		109年度(註2)	110年度(註2)	111年度(註3)	112年度(註3)	113年度(註3)
項目						
流動資產		632,377	665,320	614,313	462,509	770,737
基金及長期投資		16,418	6,565	-	-	-
固定資產		414,806	469,383	505,376	487,559	508,843
無形資產		-		14,050	7,486	14,202
其他資產		35,294	37,517	84,260	106,177	107,990
資產總額		1,098,895	1,178,785	1,217,999	1,063,731	1,401,772
流動負債	分配前	747,303	727,534	749,530	788,308	909,311
	分配後	747,303	727,534	749,530	788,308	909,311
長期負債		-		-	-	-
其他負債		845	816	48,672	41,770	152,888
負債總額	分配前	748,148	728,350	798,202	830,078	1,062,199
	分配後	748,148	728,350	798,202	830,078	1,062,199
股本	分配前	101,000	101,000	101,000	207,380	237,250
	分配後	101,000	101,000	200,000	207,380	237,250
資本公積		-	-	-	16,527	35,806
保留盈餘	分配前	249,727	349,618	318,321	9,335	66,327
	分配後	249,727	349,618	219,321	9,335	66,327
長期股權投資未實現跌價損失		-	-	-	-	-
累積換算調整數		20	(183)	149	106	(97)
股東權益總額	分配前	350,747	450,435	419,797	233,653	339,573
	分配後	350,747	450,435	419,797	233,653	339,573

註1：上述各年度財務資料均經會計師查核簽證之財務報告

註2：109年度及110年度係採用我國企業會計準則編製之個體財務報告

註3：111~113年度係採用國際財務報導準則編製之合併財務報告

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		111年	112年	113年
項目				
財務比率	毛利率(%)	23.49	21.68	36.23
	流動比率(%)	81.96	58.67	84.76
	應收帳款天數(天)	49	64	48
	存貨週轉天數(天)	89	144	98
	負債比率(%)	65.53	78.03	75.78

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)

修訂日期：113年7月